

华创证券有限责任公司
关于气派科技股份有限公司
2026年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责气派科技持续督导工作，并出具2026年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制度制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与气派科技签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解气派科技的业务发展情况，对气派科技开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	气派科技在本持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情形
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，自发现或应当发现之日起五个交易日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	气派科技及相关当事人在本持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在本持续督导期间，保荐机构督导气派科技及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规

序号	工作内容	持续督导情况
		则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会以及董事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促气派科技依照相关规定健全和完善公司治理制度，并严格执行，督导董事、高级管理人员遵守行为规范
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对气派科技的内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查，气派科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促气派科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，及时向上海证券交易所报告	保荐机构对气派科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管措施的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	保荐机构关注到本持续督导期间气派科技及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	保荐机构关注到本持续督导期间气派科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如	保荐机构关注到本持续督导期间气派科技不存在应及时向上海证券交易所报告的情况

序号	工作内容	持续督导情况
	实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，及时向上海证券交易所报告	
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	本持续督导期间，气派科技未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的，自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	保荐机构关注到本持续督导期间气派科技不存在前述情形

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

保荐机构对气派科技本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，气派科技严格按照证券监管机构的相关规定进行了信息披露，依法及时公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

四、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）业绩亏损的风险

报告期内，公司营业收入51,790.75万元，同比增长58.91%；归属于上市公司股东的净利润1,192.02万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润593.10万元，实现扭亏为盈。若未来半导体行业景气度下降，可能导致公司业绩增速下降，也可能导致公司业绩亏损。

（二）封装测试领域技术及产品升级迭代风险

近年来，半导体终端系统产品的多任务、小体积的发展趋势带动了半导体封装技术朝着高性能、高密度、高散热、晶圆级、薄型化、小型化方向快速发展，相应的FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV等先进封装技术应用领域越来越广泛。国际半导体封测行业呈现高度集中化竞争格局，台积电、三星、英特尔等Foundry厂商凭借先进制程和封装技术（如3D封装、CoWoS等）强势切入先进封装领域，对传统OSAT（外包封测服务）企业形成挤压。例如，台积电的CoWoS技术已成为AI芯片封装主流，而日月光等企业需加速布局FOPLP（面板级扇出型封装）以应对技术替代风险。若传统封测企业无法在技术研发上持续突破，可能面临市场份额流失风险。

日月光、安靠、长电科技、华天科技、通富微电等国内外领先企业均已较全面的掌握FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV、Chiplet等先进封装技术，而公司产品目前仍以SOP、SOT、DFN/QFN为主。如果未来公司的封装技术与工艺不能跟上竞争对手新技术、新工艺的持续升级换代，将可能使得公司市场空间变小；或者公司不能对封装测试产品的应用领域和终端市场进行精准判断，快速识别并响应客户需求的变化，在新产品、新技术研发方面无法保持持续投入，或者正在研发的新产品不能满足客户需要，将难以开拓新的业务市场；进而对公司的经营业绩造成不利影响。

（三）研发技术人员流失风险

公司自成立以来一直从事半导体封装测试业务，所处行业为资金、资产、技术、管理和人才密集型行业，优秀的研发技术人员是公司赖以生存和发展的

重要基础，是公司获得和保持持续竞争优势的关键。随着半导体封装测试市场竞争的不断加剧及新的参与者加入，企业之间对人才尤其是优秀研发技术人员的争夺将更加激烈，若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇、设立具备较强吸引力的激励考核机制，公司将难以持续引进并留住优秀研发技术人员，公司将可能面临研发技术人员流失的风险；如果出现研发技术人员流失，公司还将面临技术泄密的风险。

（四）毛利率波动风险

公司主要从事半导体封装测试业务，经营业绩会随着终端产品市场的波动而变化；同时，半导体封装测试行业竞争激烈，价格相对透明，相应的封装测试企业整体毛利率水平不高。未来若终端产品市场出现较大波动，或者随着市场竞争的加剧、竞争者的数量增多及技术服务的升级导致公司调整产品及服务的定位、降低产品及服务的价格，公司产品毛利率水平存在较大幅度波动的风险，从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

（五）生产效率下降风险

随着公司生产规模的不断扩大、工艺流程的日益复杂，如果半导体行业持续处于低迷的市场行情，公司未来不能在管理方式上及时创新，生产人员技术水平及熟练程度无法保持或者持续提升，公司将会面临生产效率下降的风险。生产效率下滑将导致公司生产规模无法保持或持续扩大，不仅会使产品交期延长、竞争力削弱及客户流失，同时还会使公司无法保持在成本控制方面的优势，将会对公司经营业绩产生不利影响。

（六）原材料价格波动风险

公司主要原材料包括引线框架、塑封树脂、丝材（金丝、银线、铜线、合金线、铝线）和装片胶。公司原材料价格受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响，若未来公司原材料价格出现大幅波动，而公司产品售价不能及时调整，将给公司的盈利能力造成不利影响。

（七）产能消化风险

随着公司募集资金项目的逐步建成和自有资金扩产的逐步实施，将有效提升公司半导体封装测试产能，使公司生产和交付能力得到进一步的提升。如果

公司下游市场需求不及预期、市场竞争加剧或公司市场开拓受阻，将可能导致部分生产设备闲置、人员富余，使得公司产能利用率不足、产能消化存在风险，从而无法充分利用全部生产能力而增加产品单位成本费用负担，将对公司未来的经营状况带来不利影响。

五、重大违规事项

2026年半年度，公司不存在重大违规事项。

六、主要财务数据及指标的变动原因及合理性

2026年半年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

主要财务数据	2026年1-6月/2026年6月30日	2025年1-6月/2025年12月31日	增减变动幅度(%)
营业收入	51,790.75	32,590.65	58.91
利润总额	1,365.13	-6,265.95	不适用
归属于上市公司股东的净利润	1,192.02	-5,866.86	不适用
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	593.10	-6,607.03	不适用
经营活动产生的现金流量净额	957.63	1,410.73	-32.12
归属于上市公司股东的净资产	75,595.48	58,206.08	29.88
资产总额	219,801.55	201,145.58	9.27

2026年半年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2026年1-6月	2025年1-6月	增减变动幅度(%)
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.55	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.55	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	-0.62	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.72	-9.38	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.86	-10.57	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	5.29	7.98	减少2.69个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1、报告期内，营业收入51,790.75万元，较上年同期增加19,200.10万元，增长58.91%，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为1,192.02万元、593.10万元，扭亏为盈，主要原因系半导体行业周期复苏，公司订单充足，产能利用率提升，使得折旧、摊销、人力等单位成本分摊有所下降；同时产品结构优化，销售价格有所上升，毛利率得到改善，共同推动业绩扭亏为盈。

2、报告期内，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益由负转正，主要原因系本期净利润扭亏为盈所致。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降32.12%，主要系本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。

综上，公司2026年半年度主要财务数据及指标变动具备合理性。

七、核心竞争力的变化情况

2026年半年度，公司核心竞争力未发生不利变化，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

（一）技术优势

半导体封装测试属于技术密集型行业，行业创新主要体现为生产工艺的创新，技术水平主要体现为产品封装加工的工艺水平。气派科技通过多年的技术研发积累与沉淀，现已形成了5G基站GaN微波射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、小型化有引脚自主设计的封装方案、封装结构定制化设计技术、产品性能提升设计技术、精益生产线优化设计技术、MEMS封装技术、大功率碳化硅塑封封装技术、基于铜夹互联的大功率硅芯片封装技术等核心技术，推出了自主定义的CDFN/CQFN、CPC和Qipai封装系列产品，对贴片系列产品予以了优化升级等，并已申请了发明专利，公司还掌握了Flip-Chip、MEMS等一流的封装技术并成功量产。

（二）人才优势

气派科技的多数高级管理人员及核心技术人员拥有多年的半导体封装测试

技术研发或管理经验，具备国际领先企业的行业视野或国内一流企业的从业经验，是一支经验丰富、结构合理、优势互补的核心团队，为持续提升公司核心竞争力、设计新产品、开发新工艺提供强有力的人力资源支持。

公司不仅在研发人员及管理团队中具备人才优势，也将人才优势进一步推广到生产一线，为近年来公司精益生产线优化设计技术的深层次应用奠定了人力资源基础。公司持续开展六西格玛等培训，建立了“新生力”“后备经理人”培养体系等，公司具备完整人才梯队和人才培养体系。

（三）生产组织与质量管理优势

半导体封装涉及的产品种类繁多，目前公司的主要封装产品包括MEMS、FC、Qipai、CPC、SOP、SOT、LQFP、QFN/DFN、CDFN/CQFN、TO、DIP、PDFN等系列。相对齐全的产品线为公司满足客户多元化的产品需求和建立市场优势发挥了重要作用。但同时，不同的产品类型往往需要不同生产工艺、生产设备、供应商体系、技术及管理队伍相匹配，这对封装企业的生产组织能力和质量管理提出了严格的要求。

公司致力于持续提升生产管理水平、强化质量管理，培养了经验丰富的研发技术人员和一大批生产管理人才。基于丰富的生产经验和成熟的技术工艺，公司采用柔性化的生产模式，能根据客户的订单要求，灵活地分配生产计划和产品组合，迅速地调试和组合生产线，实现高效率、多批次、小批量的生产，有效地增强了市场反应能力。公司建立了严格的质量管理体系，完善了工作规范和质量、工艺控制制度，并通过了ISO9001:2015质量管理体系、IATF16949:2016汽车行业质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系和ISO22301业务连续性管理体系认证。

（四）地域优势

公司客户主要为芯片设计企业，其对交货时间要求严格，交货时间短和便利的地理位置可为芯片设计企业减少库存，节约运输时间和资金成本，及时应对来自客户的随机性和突发性需求，方便企业与客户交流和反馈，增强其竞争力。

公司地处粤港澳大湾区，电子元器件配套市场的迅速崛起以及半导体设计

行业的蓬勃发展为气派科技提供了快速发展的沃土。公司充分发挥地域优势进行客户开拓，通过上门接送货物等服务方式节约运输时间、缩短交货期和降低物流成本，加深与客户的交流，销售服务利于得到客户认可，提高公司市场占有率。

（五）规模优势

芯片设计公司选择长期合作伙伴时，着重考虑封装测试厂商是否具备足够的产能规模，是否具备大批量、高品质供货的能力。为构建公司在国内封装测试行业的规模优势，公司在东莞投资完成了自有厂房的建设，为持续的产能扩充以及技术改造提供了物理条件。

公司现已发展成为华南地区规模最大的内资封装测试企业之一，已形成了自身的规模优势。同时，公司仍在进行持续的资本性支出，有助于公司继续利用规模优势来巩固和提高公司在行业内的竞争地位。

（六）智能化生产优势

近年来，公司秉承打造智能化工厂为目标，按照数字工厂总体设计和布局，先后从网络安全、系统架构、数据分析等多方向规划、持续建设，陆续导入制造执行系统（MES）、先进排产计划系统（APS）、设备控制自动化系统（EAP）等系统，并与企业资源计划管理系统（ERP）集成，实时数据平台与生产管理系统实现互通集成，从而建成制造资源数字化、生产过程数字化、现场运行数字化、质量管控数字化、物料管控数字化的智能工厂，生产数据通过工况在线感知、智能决策与控制、设备自律执行大闭环过程，不断提升设备性能、增强自适应能力，实现研发、生产、运营的全流程数字化管理，最优化分派生产订单和工作任务，全流程追溯生产过程中的物料、治具条码等，有效提高制造资源利用率、人均产能、产品质量良率，有效降低生产成本。2022年，公司全资子公司广东气派荣获“东莞市智能制造示范项目”“东莞市智能工厂”称号，2023年，广东气派“精益生产管理”和“质量精准追溯”两个场景入选“工信部智能制造优秀场景”名单。

八、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

2026年半年度，公司研发投入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2026年1-6月	2025年1-6月	变化幅度（%）
费用化研发投入	2,741.31	2,602.12	5.35
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	2,741.31	2,602.12	5.35
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.29	7.98	减少2.69个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

（二）研发进展

2026年半年度，公司的主要在研项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	中低功率器件大矩阵封装技术开发	500.00	185.04	337.76	小批量阶段	开发一款大矩阵功率器件封装产品，降低生产成本，提升产品竞争力	行业先进水平	广泛应用于消费电子领域的电源驱动等
2	高密度高集成薄型QFP封装开发及产业化	218.00	67.32	81.05	工艺开发验证阶段	开发一系列薄型TQFP封装形式，丰富公司封测种类，同时采用高密度设计，降低成本，提升竞争力	行业先进水平	广泛应用于工业及消费类微机控制领域
3	小尺寸低成本高密度LQFP封装技术开发	210.00	50.19	52.01	工艺开发验证阶段	开发一系列LQFP封装形式，丰富公司封测种类，同时采用高密度设计，降低成本，提升竞争力	行业先进水平	广泛应用于工业及消费类微机控制领域
4	高可靠性高频LGA封装平台开发及产业化项目	960.00	7.76	7.76	设计开发验证阶段	开发多款LGA封装，适用于氮化镓射频和普通集成电路芯片，丰富公司产品类型，扩展封装技术，提升竞争力	行业先进水平	应用于5G通信、物联网等领域
5	低压大电流功率器件铜片夹扣键合技术研发及产业化（注）	1,500.00	231.23	1,631.21	小批量阶段	设计开发承载电流能力更大的clip封装，建立Clip封装生产工艺并产业化	行业先进水平	广泛应用在计算机，工控和汽车领域，如主板供电、电动工具，助力转向控制等

6	MOSFET 双面散热封装技术开发	850.00	391.90	571.82	工艺开发验证阶段	开发公司第一款双面散热封装，提升PDFN56散热能力，提升公司在功率器件封装技术领域优势，达到国内先进水平	行业先进水平	应用于大功率无人机、汽车助力转向控制等领域
7	系统级功率器件双面散热封装和测试技术研发及产业化	1,200.00	445.23	927.10	工艺开发验证阶段	开发设计 1~2 款高散热的系统级 QFN 功率器件封装，满足日益增长的算力芯片供电需求，完善公司功率器件封装技术能力	行业先进水平	应用于高端的 CPU 和 GPU 供电领域
8	扁平无引脚倒装封装及真空塑封技术开发	700.00	414.07	421.54	工艺开发验证阶段	开发 Q/DFN Flipchip 及真空塑封技术，丰富公司封装种类，并提升工艺能力	行业先进水平	广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制、通信与网络、便携医疗、物联网终端及功率与射频器件等领域
9	高可靠性的小尺寸薄型 SSOP28 封装开发及产业化	900.00	201.57	201.57	工艺开发验证阶段	开发 TSSOP28 和 ETSSOP28 封装，丰富公司封装类型，提升竞争力	行业先进水平	应用于电机驱动、音频功放、电源管理、显示驱动
10	超高密度微小外形封装技术开发	750.00	30.51	30.51	设计开发验证阶段	开发 100 宽 15 排的 MSOP8 和 EMSOP8 封装，降低生产成本，提升市场竞争力	行业先进水平	常用于智能手机、可穿戴设备、物联网（IoT）终端等
合计	/	7,788.00	2,024.82	4,262.33	/	/	/	/

注：低压大电流功率器件铜片夹扣键合技术研发及产业化项目期后预算由1,500.00万元提升至1,850.00万元。

报告期内获得的知识产权如下：

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	0	0	112	56
实用新型专利	7	9	227	196
外观设计专利	0	0	88	73
软件著作权	0	0	1	1
其他	0	0	0	0

合计	7	9	428	326
----	---	---	-----	-----

注：以上累计数量统计中不含已失效专利。

九、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

十、募集资金的使用情况及是否合规

（一）实际募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2026年1月14日出具的《关于同意气派科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]79号）同意注册，公司于2026年2月向特定对象发行股票数量790.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为20.11元/股，募集资金总额为人民币15,886.90万元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币397.74万元，实际募集资金净额为人民币15,489.16万元。

该次募集资金到账时间为2026年2月4日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年2月4日出具天职业字[2026]3637号验资报告。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金实际使用情况及期末余额

2026年1-6月，公司累计使用募集资金15,439.16万元，用途均为补充流动资金。截止2026年6月30日，募集资金账户期末余额为50.03万元（包含募集资金利息收入）。

截止2026年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：万元

存放银行	银行账户账号	存入方式	期末余额
中国工商银行深圳平湖支行	4000024319201319435	活期存款	50.03

存放银行	银行账户账号	存入方式	期末余额
合计			50.03

公司2026年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十一、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2026年6月30日，气派科技控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员直接持有公司股份及变动的情况如下：

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量
梁大钟	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	45,790,000	46,190,000	400,000
白瑛	实际控制人、董事	10,800,000	12,000,000	1,200,000
梁华特	实际控制人	-	6,300,000	6,300,000
饶锡林	副总经理、核心技术人员	280,000	280,000	-
文正国	副总经理、董事会秘书	310,000	310,000	-
李泽伟	董事、财务总监	295,000	295,000	-
施保球	核心技术人员	1,079,800	856,712	-223,088
曹周	核心技术人员	18,000	15,500	-2,500
张怡	核心技术人员	9,600	6,912	-2,688
黄乙为	核心技术人员	8,000	5,760	-2,240

2026年2月，气派科技完成了2025年向特定对象发行A股股票，该次发行的股票由公司实际控制人梁大钟、白瑛及其关联方梁华特全额认购。该次发行完成后，梁大钟先生仍为公司的控股股东，公司实际控制人由梁大钟、白瑛变更为梁大钟、白瑛、梁华特。

截至2026年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员直接持有的股份均不存在质押、冻结的情形。

十二、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，气派科技不存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于气派科技股份有限公司2026年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 王兆琛
王兆琛

王江
王江

